

[19] Patents Registry  
The Hong Kong Special Administrative Region  
香港特別行政區  
專利註冊處

[11] 1008114 A  
EP 0438444 B1

[12]

**STANDARD PATENT SPECIFICATION**  
**標準專利說明書**

[21] Application No. 申請編號  
98107155.9

[51] Int.Cl.<sup>6</sup> H01L

[22] Date of filing 提交日期  
27.06.1998

<p>[30] Priority 優先權 05.10.1988 US 253639</p> <p>[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期 30.04.1999</p> <p>EP Application No. &amp; Date 歐洲專利申請編號及日期 EP 89911147.0 14.09.1989</p> <p>EP Publication No. 歐洲專利發表編號 EP 0438444</p> <p>Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的發表日期 02.10.1996</p> <p>[86] International Application No. 國際申請編號 PCT/US89/04135</p> <p>[87] International Publication No. 國際申請發表編號 WO 90/04262 (19.04.1990)</p>	<p>[73] Proprietor 專利所有人 OLIN CORPORATION, Cheshire, CT 06410-0586, United States of America 美利堅合眾國</p> <p>[72] Inventor 發明人 MAHULIKAR, DEEPAK POPPLEWELL, JAMES M.</p> <p>[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址 Johnson Stokes &amp; Master, 18/FI., Prince's Building, 10 Chater Road, Hong Kong 孖士打律師行，香港中環遮打道 10 號太子大廈 18 字樓</p>
--	---

[54] ALUMINUM ALLOY SEMICONDUCTOR PACKAGES 鋁合金半導體綜合設備